# Improvement of in-situ measurement method of degree-of-cure of FRP prepregs

知能機械システム工学コース

先端機械・航空材料工学研究室 1225029 須賀 絃貴

## 1. 緒言

FRP 製品は軽量,高強度,高剛性といった長所を持つ ため、様々な分野で活用が期待されている.しかし、複 雑な形状のFRP の製造には物体内部の温度分布によって、 硬化度にムラが生じる.この硬化度のムラはFRP 製品の 品質低下に繋がるため、現在では試行錯誤的に最適な成 形条件の探索が行われている.しかし、この探索手法は 非常に効率が悪く、コスト増加の要因となっている.そ こで、FRP の効率的な最適成形条件の探索手法が必要と されている.<sup>1)</sup>

本研究室では、成形後の品質補償が必要の無いその場 測定に着目し、物体内部の状態を埋め込みが可能な光フ ァイバセンサを用いることで FRP のその場硬化度測定手 法の構築を行ってきた.しかし、本手法を FRP プリプレ グの硬化度測定に用いた場合、大きな測定誤差が生じる 場合があることが確認されている.そこで、FRP プリプ レグの硬化度測定精度の向上を目的として、誤差発生の 原因を明らかにするためにいくつかの実験を行った.

2. CFRP プリプレグのその場硬化度測定

2.1 埋め込み光ファイバセンサによる硬化度算出 図1に物体に埋め込みが可能なフレネル反射型光ファ イバセンサによる屈折率測定の概略を示す.光源から照 射された光はサーキュレータを介して FRP 内部に入 り、端部で光ファイバのガラスと樹脂の屈折率の違いに よりフレネル反射を起こす.反射された光は再度サーキ ュレータを介し、受光器でその光量を測定する.測定さ れた光量から式(1)を用いることで成形中の樹脂の屈折率 変化Δnを算出する.

$$\Delta n$$

$$n_{eff} + n_s$$

$$=\frac{\eta_s(1+\eta_s)+\eta_{air}^2\nu\pm(1+\eta_s)\sqrt{\eta_s^2+\eta_{air}^2\nu}}{1-(\eta_s^2+\eta_{air}^2\nu)}$$
(1)

$$\eta_{air} = \sqrt{R_{air}} = \frac{n_{eff} - 1}{n_{eff} + 1}$$
,  $\eta_s = \sqrt{R_s} = \frac{n_{eff} - n_s}{n_{eff} + n_s}$ 

$$\nu = \frac{\Delta I}{I_{air} - I_{b}} \approx \frac{\Delta I}{I_{air}}$$

ここで、 $n_s$ は基準条件(本研究では測定開始温度 $T_s$ ,硬化度 0)での樹脂の屈折率、 $n_{eff}$ は光ファイバの有効屈折率、 $\Delta I$ は反射光量の変化、 $I_{air}$ は空気からの反射光量を示す。

図2に CFRP プリプレグの成形温度と屈折率変化の関係を示す.図2より、樹脂の屈折率は温度に依存し、硬化開始前と硬化完了後は互いに線形であることがわかる. また、硬化開始前にはノイズが見られる.このノイズは光ファイバ先端に付着したエアボイドによって生じると考えられる.また、散乱体による散乱光はスペクトル形状に大きく影響を与えるため、スペクトルから散乱の度合いを知ることが可能となる.

測定開始温度 $T_s$ での屈折率 $n_s$ は、参照温度 $T_o$ での屈 折率 $n_o$ を用いて、式(2)より求められる.ここで $T_o$ は実験 結果から得られた参照温度を示す.



Fig1. Schematic view of refractive index measurement by Fresnel-based optical fiber sensor.



Fig2. Relationship between refractive index variation of CFRP prepreg and molding temperature.

$$n_s = \frac{dn}{dT}(0)(T_s - T_o) + n_o \tag{2}$$

樹脂の硬化度は式(3)より求められる.

1

$$\alpha = \frac{\Delta n(\alpha, T) - \frac{dn}{dT}(0)(T - T_s)}{\Delta \tilde{n}(1, T_o) + \left\{\frac{dn}{dT}(1) - \frac{dn}{dT}(0)\right\}(T - T_o)}$$
(3)

ここで, Δn(α,T)は硬化度 α, 温度 T の場合での屈折率 変化, dn/dT (α)は図 2 の屈折率の温度依存を示す.<sup>2)</sup>

### **2.2** CFRP プリプレグのその場硬化度測定

本研究では、CFRP プリプレグ 10 枚を1 方向に積層し、 繊維方向に熱電対と光ファイバを埋め込み、ホットプレ ス機で試験片の成形を行った.温度パターンは 5.0℃/min, 3.0℃/min, 2.0℃/min, 1.0℃/min で 220℃まで昇温させた. 表 1 に実験より得られた硬化度算出用パラメータを示す. 表 1 の各パラメータを用いて硬化度算出を行った.また、 硬化開始前に生じるノイズを除去するために本研究では、 閾値法と LPF を用いてフィルタリング処理を施した.閾 値法では大きいノイズの除去を行い、LPF で残った小さ

#### いノイズの除去を行う.

図 3 に本研究で構築したシステムを用いて算出した CFRP プリプレグの硬化度を成形温度に対して示す. 図 3 より,本研究で構築した CFRP プリプレグのその場硬化 度測定システムを用いることで,図 2 の硬化開始前に生 じたノイズの除去が行えていることがわかった. 1,2, 3℃/min の温度パターンでは硬化度がほぼ 1 を示してい るため,本システムを用いることで硬化度の算出が可能 であることがわかった.しかし,昇温速度 5.0℃/min の場 合では最終的な硬化度の値が 0.91 を示しており,誤差が 生じた.本研究は、このエラーの要因が硬化度 0.6~0.7 付近で生じる乱れによるものではないかと考えた.その 発生要因を明らかにする実験を行った.



Fig3. Filtered degree-of-cure curves of CFRP prepregs.

Table1. Material constants for calculating degree-of-cure.

dn/dT(0)	dn/dT (1)	$\Delta \tilde{n}(1,T_o)$	$T_o(\text{deg})$	$T_s(\text{deg})$
-3.12E-4	-3.29E-4	0.0283	105	105

#### 3. 硬化度曲線に生じる乱れの原因の調査

3.1 成形圧が光量に与える影響の調査

成形中の CFRP プリプレグに光ファイバを埋め込む場合, 試験片を加圧すると, 光ファイバの断面は変形し, それによって光損失が生じる.本研究では成形圧による 損失量を調べるための実験を行った.

図4に実験方法の概略を示す.光ファイバ端部を試験 片外部に出すように設置した.図5に光量の損失量を百 分率で表記したものと成形温度の関係を示す.caselで は樹脂が溶融し始める107℃付近で加圧し、樹脂の硬化 が開始する125℃付近で圧を抜き光量の損失量を調べ た.また,case2では硬化度測定と同様に,105℃付近で 加圧した後220℃まで成形圧を保持した.図5から成形 圧による測定光量への影響は最も高い数値でも0.4%と 非常に小さいことがわかった.よって,成形圧が硬化度 曲線に与える影響は無視できるほど小さいと言える.空 気との反射光量から埋め込まれた部分で生じる光量損失 を調べることができる.



Fig4. Experimental set-up for measuring optical loss of embedded optical fiber in CFRP during hot-press molding.



Fig5. Relationship between optical loss and temperature during molding.

3.2 光ファイバ端部における散乱光との干渉度合い 樹脂の硬化による測定光量のスペクトルを測定するこ とで散乱光と干渉の度合いを調査した.測定波長範囲は SLD 光源の帯域に合わせて 1310±50 nm とした.

図 6 に昇温速度 3.0℃/min で成形した場合の硬化度曲線を成形時間に対して示す.硬化完了後の硬化度がおよそ 1.2 の数値を示すことからわかるように,正確に硬化度の算出が行えなかった.図7に光スペクトルを示す. なお図には昇温開始時(a),樹脂溶融時(b),硬化度 0.6 (c),樹脂硬化完了時(d),のスペクトルを示した.図7より,初期スペクトル(a)はガウス関数形状であり,干渉が見られることがわかる.光ファイバ端部が樹脂と接触したおよそ 900 秒から溶融する 1600 秒までは大きなノイズが 生じるのは第2章で述べた通りである.樹脂溶融後スペ





(dBm)

Amplitude

Fig7. Reflected spectra from sensor, embedded in CFRP.

クトル(b)では、小さな干渉が生じていることがわかる. この干渉は成形中に生成したり消滅したりを繰り返すこ とがわかった.これは散乱体であるエアボイドが成形中 に移動しているためだと思われる.スペクトル(c)を見る と、この結果で生じている干渉は極端に大きく、端面反 射光とほぼ同級度の散乱がファイバに入射していること がわかった.スペクトル(d)を見ると干渉の大きさは変わ っておらず、ファイバ先端付近にボイドが残留してしま ったことを示している.

ボイドの動きをより詳細に調べるために、光のスペクトル $S(\lambda)$ から FFT(Fast Fourier Transform)を用いて空間 周波数スペクトルを求めた。光源スペクトルをとする と、 $S_0(\lambda)$ 散乱体からの干渉の影響を受けたスペクトル は以下の式で表される。

$$S(\lambda) = S_0(\lambda)(1 + A\cos\left[2\pi n\frac{x}{\lambda_0}\right]) \tag{4}$$

ここで *n* は樹脂の屈折率, *x* は往復光路長であり、図 8 に示すように x=2d である. FFT から求めた空間スペ クトルのピーク位置は *x* であるので、これより散乱体と ファイバの距離 *d* を求めた.

ピーク位置は照射した光の信号との差が 25dB 以下の 信号を検出した. 図9に光ファイバ端部と散乱体の距離 を時間に対して示す. 図9より,樹脂溶融前およそ1000 秒から 1600 秒にかけてファイバ端部付近  $0.02 \mu$  m から  $0.15 \mu$  m に流動していることがわかる. これは樹脂立地 と考えられる. また樹脂が溶融した 1600 秒付近では一度 散乱体が検出されず,樹脂硬化途中の 1800 秒から 2100 秒で再び生成され,  $0.1 \mu$  m から  $0.33 \mu$  m 付近を流動する 動きが見られた. この硬化途中に生成される散乱体が硬 化度測定に大きく影響を与えていると考えられる. 硬化 完了後は一定の位置に留まることが明らかになった.



Fig8. Overview of frequency measurement using FFT.



3.3 散乱体と干渉の大きさが硬化度算出に及ぼす影響本研究では以下の条件で試験片を作成し、散乱体の供給を抑制した.光の干渉の度合いと硬化度算出精度の比較を行い、干渉の大きさが硬化度算出に及ぼす影響を調べた.パターン1,散乱体の供給源は光ファイバ埋め込み部分からできる空洞の可能性があるため、従来埋め込む光ファイバの被覆を端部のみ剥がしていたが、埋め込み部分全体を剥がすことで光ファイバの径を小さくし、埋

め込み部分からの流入を抑制する.パターン2,樹脂が流動しやすい温度で温度保持(110℃で1時間)を設け,樹脂硬化途中に試験片内部で流動する散乱体を外部へ流出させる.パターン3,パターン1と2を混合させることで散乱体の挙動を明らかにする.

図10に、第3章で示した干渉が大きく生じたスペクトル ル(以下エラーパターン)と、各パターンのスペクトル を横軸に波長、縦軸に光量として示す.十分に硬化が進 んだ硬化度0.9の領域を測定した.図10よりエラーパタ ーンと比較すると、どの条件下でも光の干渉振幅が明ら かに小さいことがわかる.また、図11にそれらの硬化度 曲線を成形時間に対して示す.図より、オリジナルと各 パターンの比較を行うと全ての条件において硬化度測定 に与える影響は小さくなっていることがわかる.これは、 スペクトルを積分したものが光量となるので、小さな干 渉であれば積分されることで除去されるためであなかった. これたのことから、王波振幅の大きさがおとそ 5% 毎

これらのことから、干渉振幅の大きさがおよそ 5%程度であれば、硬化度のエラーは同程度に収まることが分かった.



Fig10. Comparison of light spectrum for each pattern.



Fig11. Comparison of degree-of-cure for each pattern.

#### 4. 結言

本研究では、CFRP プリプレグに適応可能なその場硬化 度測定手法の改良と、硬化度曲線に生じるズレの原因に ついて調査を行った.その場測定では硬化度算出用パラ メータを再取得したことで硬化度算出精度の向上が見込 めた.硬化度曲線に生じるズレの要因は樹脂溶融時に生 成される微小なボイドが散乱体となっていることがわか った.また、この散乱体による干渉の度合いが小さいと 硬化度測定精度に与える影響が小さくなることがわかった.

成形温度に温度保持を設けて樹脂溶融によって生成されるボイドを外部へ流動させることで硬化度測定精度の 向上が見込めることがわかった.また,光ファイバの径 を小さくすることで,散乱体の流入を抑制できる可能性 を示すことができた.

#### 参考文献

- T.Kosaka, Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol.67, No.8, pp.819-825(2018)
- (2) T.Kosaka, K.Osaka, and Y.Sawada, Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol.59, No.5, pp.391-397(2010)